



온세미코리아 현장실습 모집 직무 소개

직무	주요 업무
Device Engineer	1) 담당 제품에 대해 통합 수율 관리를 진행한다. 2) 대량 생산을 위한 공정 통합 및 Yield성과와 관련된 KPI 목표를 설정한다. 3) FAB&Unit probe에서 타부서와 협업하여 문제를 해결한다. 4) 품질 이슈 및 프로젝트를 지원한다. 5) 양산에 신제품 및 신규 공정 도입을 검토하고 시행한다.
Process Engineer	1) 안정적이고 경쟁력 있는 단위 프로세스를 구축한다. (생산성/품질/원가/기술) 2) 단위프로세스에서 발생하는 각종 문제를 해결한다. 3) 불안정한 프로세스를 최적화하고 개선안을 도출한다.
Application Engineer	1) On Board Charger 및 Motor Drive, Exciter, PTC, Static Switch 등과 같은 모든 자동차 응용 분야에서 저전압 및 고전압 Super Junction MOSFET 및 SiC, IGBT, 게이트 드라이버 등 신제품 개발을 지원한다. 2) 신제품 개발을 지원하며 이에 따른 포트폴리오와 관련된 제품 홍보 자료 또한 함께 지원한다. 3) 신제품을 특성화하는 데 사용할 수 있는 새로운 테스트 회로와 PCB 레이아웃 및 시뮬레이션 도구를 개발하는 데 도움을 준다. 4) 고객을 위한 적극적인 지원을 통해 당사의 제품 디자인 원을 수행하는데 노력한다.
Product Engineer	1) 제품을 개발하고 생산하기 위한 연구개발이나 생산현장에서 제품을 생산하기 위한 제반활동을 지원하는 업무를 수행한다. 2) Business Unit을 대표하여 고객에게 제품 엔지니어링 지원을 제공하고, 제조 및 품질 엔지니어링 팀과 협력하여 할당된 제품의 품질, 비용, 정시 공급등을 위한 개선 업무를 진행한다. 3) 최종 제품의 Datasheet을 관리하고 제품 생애 주기동안 발생하는 각종 변경사항에 대하여 Engineering 적인 결정을 한다.
Digital Design Engineer (Image sensing)	1) Logic 설계 - ERS 및 global shutter의 Timing control design - image sensor의 Analog interfaces 2) Back-End Processes - design compiler에 의한Synthesis - PrimeTime에 의한 Static timing 분석 - Formality에 의한 Logic equivalence Test 3) Verification - 수백만 gate ASIC 기능 검증 및 verification 환경 설정 - verification component 설계, functional coverage 와 assertions 구현 - UVM experience
Package Development Engineer	1) 새로운 Package 디자인 구상 및 개발 2) Manufacturing Review, Design Rules Review, worksheet documentation 3) requirements를 위한 Design 수행 4) 패키지 플랫폼을 위한 Design FMEA 시작 및 유지 5) DOE 및 process, material characterization, robustness 연구 수행 6) drawing/documentation/Marking and Bonding Diagrams, BOM 7) Process flow 및 중요/신규 control plan 수립 8) Package development documentation 9) simulation, concept 증명, 기술 시연 및 기술 출시 단계를 포함한 패키지 실행가능성 검토 10) prototype/concept Design 및 engineering builds 지원